

Lagenaufbau

Ebene	Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1	Cu+galv.Cu Tr-Lam Cu	1.20	18+25 35	
2	Prepreg No-Flow-PP No-Flow-PP	0.048 0.063 0.063		106 106 106
3	Abdeckfolie Cu Flex-Lam	0.075 0.065		PI+Kleber PI+Kleber
4	Cu+galv.Cu		18+25	

Presslingsdicke*	1,55	+/- 10%
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstopmmaske*	1,66	+/- 10%

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- * Dickenberechnung mit Basismaterial FR-4 ungefüllt bei 50% Kupferbelegung auf Innenlagen (abhängig von Basismaterialtyp, gewählter Kupferdicke und Kupferbelegung abweichende resultierende Isolations- und Enddicken)
- Dickentoleranz Basismaterial +/-10%
- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 200 µm
	Viapad-Ø	≥ 500 µm
Leiterbild Außenlagen		

Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
Leiterbild Innenlagen		
	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥ 65 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 80 µm
Standard	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 85 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 100 µm